分析・解析サービス

パッケージ開封

内部をキズつけない、高度なモールド開封技術

レーザー開封+ケミカル開封+観察

レーザー開封機や酸及び有機系の薬品で電子部品のパッケージ部を溶かし、ボンディングワイヤーの接合状態やチップ内の配線状態を観察します。

また、断面研磨の技術と合わせて、多種多様な解析用試料作製も可能です。

1 レーザー開封

IC樹脂をレーザーにより除去します。処理時間の短縮に加え試料へのダメージを大幅に低減できます。

2 ケミカル開封による開封

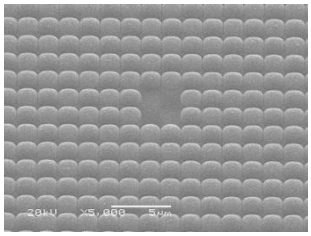
酸を使う方法と有機溶剤を使う方法の２種類があります。

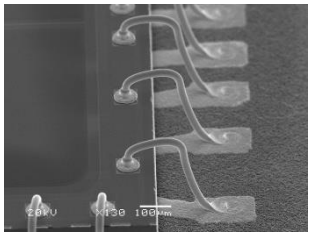
酸を使う場合は、発煙硝酸や硫酸を用いますが、酸には、パッケージの中身まで傷めてしまうリスクがありますので、薬液を有機溶剤に変えて溶解度を調整することも可能です。

3 観察

出来上がった試料をSEM-EDX(走査型電子顕微鏡）を用いて高精度に観察し構成元素を特定します。

■実例：SEM観察画像





ご相談およびご依頼の内容は、機密厳守を第一に細心の注意を払っています。特にご要望の場合は秘密保持契約をさせていただきます。

エスタカヤ電子工業株式会社
〒719-0301　岡山県浅口郡里庄町里見3121-1
TEL：0865-64-4131　FAX：0865-64-4474